

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公表番号】特表2001-502260(P2001-502260A)

【公表日】平成13年2月20日(2001.2.20)

【出願番号】特願平10-518468

【国際特許分類第7版】

B 3 2 B 25/08

G 0 3 G 15/20

【F I】

B 3 2 B 25/08

G 0 3 G 15/20 1 0 3

【手続補正書】

【提出日】平成16年10月4日(2004.10.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年 10月 4 日

特許庁長官 小 川 洋 殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第518468号

2. 補正をする者

名称 ネクスプレス ソリューションズ リミティド ライアビリティ
カンパニー

3. 代 理 人

住所 〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル

青和特許法律事務所 電話 03-5470-1900

氏名 弁理士(7751) 石 田 敬



4. 補正対象書類名

明細書及び請求の範囲

5. 補正対象項目名

明細書及び請求の範囲

6. 補正の内容

1) (イ) 明細書第20頁下から4～3行「75トン/平方インチ」を『75トン/平方インチ ($11.6 \times 10^3 \text{ kg/cm}^2$)』と補正する。

(ロ) 同第21頁最下行の後に次の文を加入する。

『本発明を特にその好ましい態様に関連して詳細に説明してきたが、本発明の精神及び範囲内において変形及び改変をなし得ることは理解されている。

以下に本発明の好ましい態様について説明する。

1. 支持体、フルオロエラストマー層及びフルオロエラストマー層の上に直接配されたフルオロポリマー樹脂粉末層をこの順に含んでなる融合部材。

2. フルオロポリマー樹脂層が、0.25～2.5ミクロンの表面粗さを有する態様



1に記載の融合部材。

3. フルオロポリマー樹脂層が、0.5～2ミクロンの表面粗さを有する態様1に記載の融合部材。

4. フルオロポリマー樹脂層が、25～75ミクロンの厚さを有する態様1に記載の融合部材。

5. フルオロポリマー樹脂層が、25～50ミクロンの厚さを有する態様1に記載の融合部材。

6. フルオロエラストマー層が、フッ化ビニリデン及びヘキサフルオロプロピレンのコポリマー又はフッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン及びテトラフルオロエチレンのターポリマーからなる、態様1に記載の融合部材。

7. フルオロポリマー樹脂粉末層が、ポリテトラフルオロエチレン、ポリペルフルオロアルコキシ、ポリフッ素化エチレンープロピレン、ポリ（エチレンテトラフルオロエチレン）、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、ポリ（エチレンークロロトリフルオロエチレン）、ポリクロロトリフルオロエチレン及びこれらのポリマーの1種又はそれ以上のブレンドからなる群から選ばれたポリマーからなる態様1に記載の融合部材。

8. フルオロポリマー樹脂粉末層がポリペルフルオロアルコキシである態様7に記載の融合部材。

9. 支持体が金属素子及びベースクッション層からなり、ベースクッション層が、シリコーンゴム、フルオロシリコーンゴム、フルオロエラストマーポリマー及びシロキサンとフルオロエラストマーポリマーとの相互浸透ネットワークからなる群から選ばれた材料からなる態様1に記載の融合部材。

10. フルオロポリマー樹脂粉末が20～40ミクロンの粒子サイズを有する態様1に記載の融合部材。

11. 支持体にフルオロエラストマー層を適用する工程及びフルオロエラストマー層に無溶媒フルオロポリマー樹脂粉末を直接適用する工程を含んでなる、支持体を有する被覆融合部材の製造方法。

12. 無溶媒フルオロポリマー樹脂粉末の層を焼結する追加の工程を含む態様11に記載の方法。

13. 無溶媒フルオロポリマー樹脂粉末の層の表面粗さが、0.25～2.5ミクロンである態様12に記載の方法。

14. フルオロポリマー樹脂粉末が10～60ミクロンの粒子サイズを有する態様11に記載の方法。

15. フルオロポリマー樹脂粉末が15～50ミクロンの粒子サイズを有する態様11に記載の方法。

16. フルオロエラストマー層に直接適用する工程を、無溶媒フルオロポリマー樹脂粉末をフルオロエラストマー層の上に成形することによって行う態様11に記載の方法。

17. フルオロエラストマー層に直接適用する工程を、無溶媒フルオロポリマー樹脂粉末をフルオロエラストマー層の上に静電粉末スプレー被覆することによって行う態様11に記載の方法。

18. フルオロポリマー樹脂粉末をフルオロエラストマー層の上に静電粉末スプレー被覆することが、フルオロポリマー樹脂粉末をガス流中に分散させる工程、フルオロポリマー樹脂粉末を高電圧場に通して、フルオロポリマー樹脂粉末に静電荷を適用する工程、支持体を接地する工程及びフルオロエラストマー層でこのフルオロポリマー樹脂粉末をスプレーして、無溶媒フルオロポリマー樹脂粉末をフルオロエラストマー層に静電的に接着させる工程を含んでなる態様17に記載の方法。

19. フルオロエラストマー層を、フルオロエラストマーポリマー、硬化剤、硬化促進剤及び酸受容剤からなる混合物を配合することによって製造し、このフルオロエラストマー層を支持体に適用する工程を、圧縮成形によって行う態様11に記載の方法。

20. 金属素子をシリコンプライマー層で被覆する工程、シリコンゴム層をシリコンプライマー層に適用する工程及びシリコンゴム層を硬化させる工程を含む各工程によって支持体を製造する態様11に記載の方法。』

2) 請求の範囲を別紙のとおり補正する。

7. 添付書類の目録

請求の範囲

1 通

請求の範囲

1. 支持体、フルオロエラストマー層及びフルオロエラストマー層の上に直接配されたフルオロポリマー樹脂粉末層をこの順に含んでなる融合部材。
2. フルオロポリマー樹脂層が、0.25～2.5ミクロンの表面粗さを有する請求の範囲第1項に記載の融合部材。
3. フルオロポリマー樹脂層が、0.5～2ミクロンの表面粗さを有する請求の範囲第1項に記載の融合部材。
4. フルオロポリマー樹脂層が、25～75ミクロンの厚さを有する請求の範囲第1項に記載の融合部材。
5. フルオロポリマー樹脂層が、25～50ミクロンの厚さを有する請求の範囲第1項に記載の融合部材。